

### 特点:

- 低插入损耗: 典型值 1.0dB
- 高隔离度: 最小值 38dB@5GHz
- SMT 封装
- 尺寸: 4×4×1.5(max)mm<sup>3</sup>
- 执行标准为 GJB8481-2015

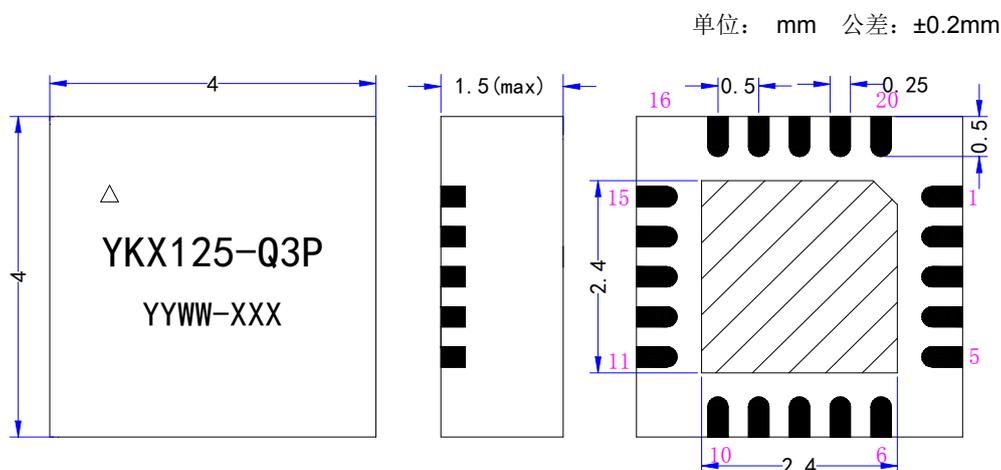
### 性能参数 (25℃):

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V <sub>DD</sub> =+5V f=0.3~5GHz 控制电平 0/+5V	0.3		5	GHz	全温
插入损耗	Li			1.5	2.8	dB	全温
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>			1.5:1	2.0:1		全温
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.5:1	2.0:1		全温
隔离度	ISO		38			dB	全温
开关时间	t			30	40	ns	
电源电压	V <sub>DD</sub>		+4.75	+5	+5.25	V	
电流	I <sub>DD</sub>			1	2	mA	
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				1.0	g	

### 极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+5.5	V	输入射频功率	+27	dBm
控制电压	低	0~0.5	储存温度	-55~+100	℃
	高	3.0~5.5			

### 封装外形图:



注: 该产品为塑封封装。

**字符标志:**

YKX125-Q3P	产品型号
Δ	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

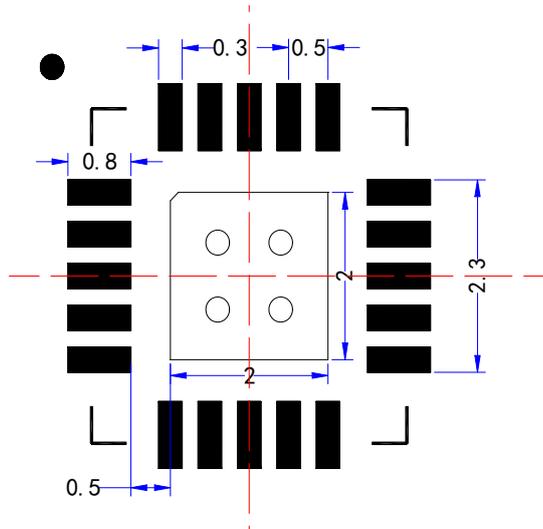
引脚编号	符号	引脚定义
1	Ctrl	控制端
3	RFC	射频输入端口,DC 耦合
5	EN	使能端口
8	RF2	射频输出端口 2,DC 耦合
18	RF1	射频输出端口 1,DC 耦合
20	V <sub>DD</sub>	电源+5V
10/11/15/16	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地
其它引脚	NC	悬空

**真值表:**

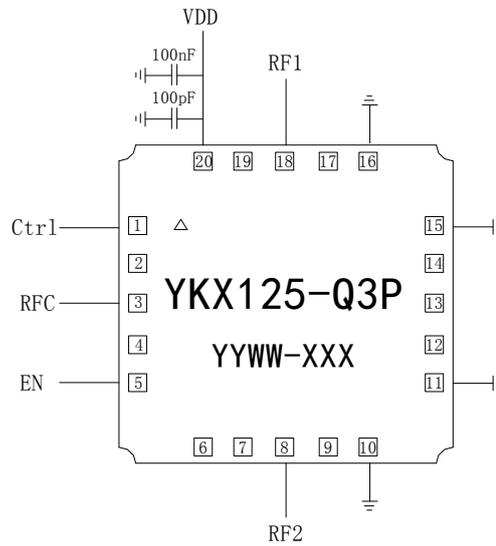
真值表: (0: 0~0.5V; 1: 3.3~5V)			
EN	Ctrl	RFC-RF1	RFC-RF2
0	0	导通	关断
0	1	关断	导通
1	0	关断	关断
1	1	关断	关断

推荐焊盘:

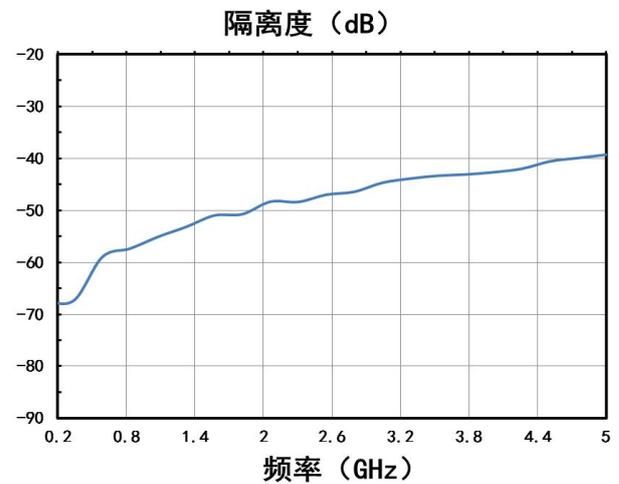
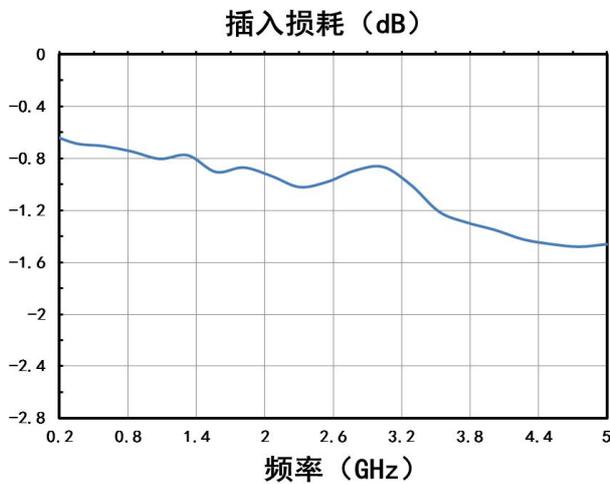
单位: mm



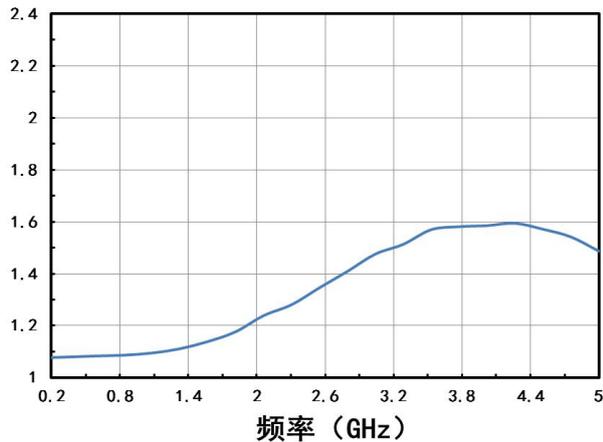
推荐外围电路:



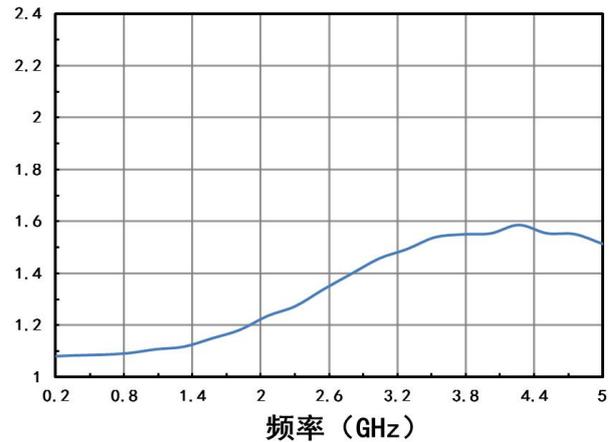
典型测试曲线:



开态输入驻波比

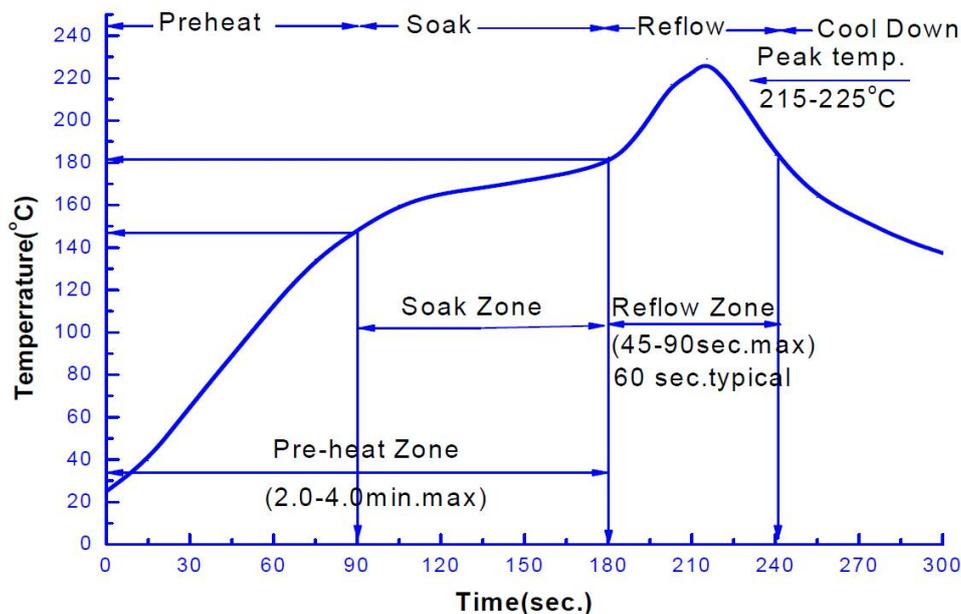


开态输出驻波比



### 产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
- 5.产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力影响可靠性。
- 6.产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 7.客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性。